

La force d'être un Groupe

Notre force est le résultat d'une synergie qui s'est développée sur plus de 50 ans au sein des sociétés évoluant dans différentes industries et appartenant toutes au groupe de Finmasi, qui se compose de quatre Divisions:

● Division en acier

Metalsider à Ravenne, fondée en 1961
Sidermed à Mordano (Bologne), fondée en 1984

● Division de capteur

M.D. Micro Detectors, fondée en 1971
Micro Detectors Ibérica, fondée en 1991
M.D. Micro Detectors Tianjin, fondée en 2012

● Division de service

Hôtel Executive et le restaurant Exé 1985 à Fiorano Modenese, fondée en 1985

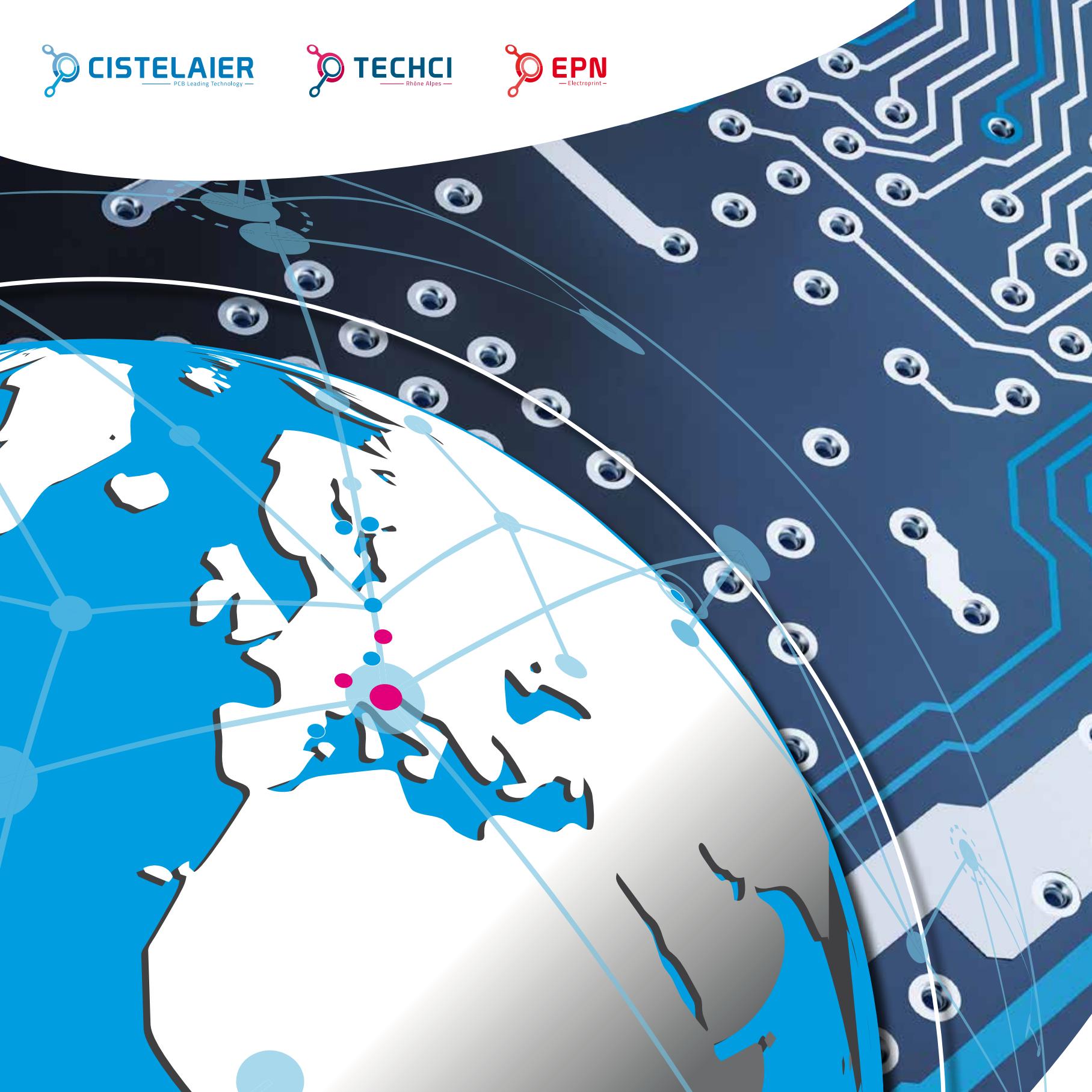
● Division PCB

Cistelaier, résultant de la fusion, réalisée par Finmasi en 1998, entre Citel à Gênes, fondée en 1976, et Laier à Modène, fondée en 1986.

Techci, basée en France (Saint-Genix sur-Guiers), fondée en 1983 et acquis par le Groupe Finmasi en 2011.

En poursuivant sa stratégie globale, le groupe de Finmasi a acquis au début de l'année 2019 la société EPN Electroprint basée en Allemagne.

Le point commun des sociétés du Groupe de Finmasi est le renouvellement constant qui permet de répondre aux besoins croissants des clients. Le Groupe de Finmasi s'engage pleinement pour garantir les conditions nécessaires à la continuité de ses sociétés.



Penser global, agir localement

Vision

Notre vision est d'être des fabricants leaders offrant des services globaux et un support local aux consommateurs Européens.

Mission

Notre mission est de:

- continuer de développer nos capacités, nos services et notre savoir-faire pour garantir avec nos usines en Europe un interlocuteur unique pour la fourniture d'un package de services et de PCBs pour tout type de technologies; double faces; multicouches et Flex-rigides de haute et de très haute technologie pour des productions séries et pour les prototypes;

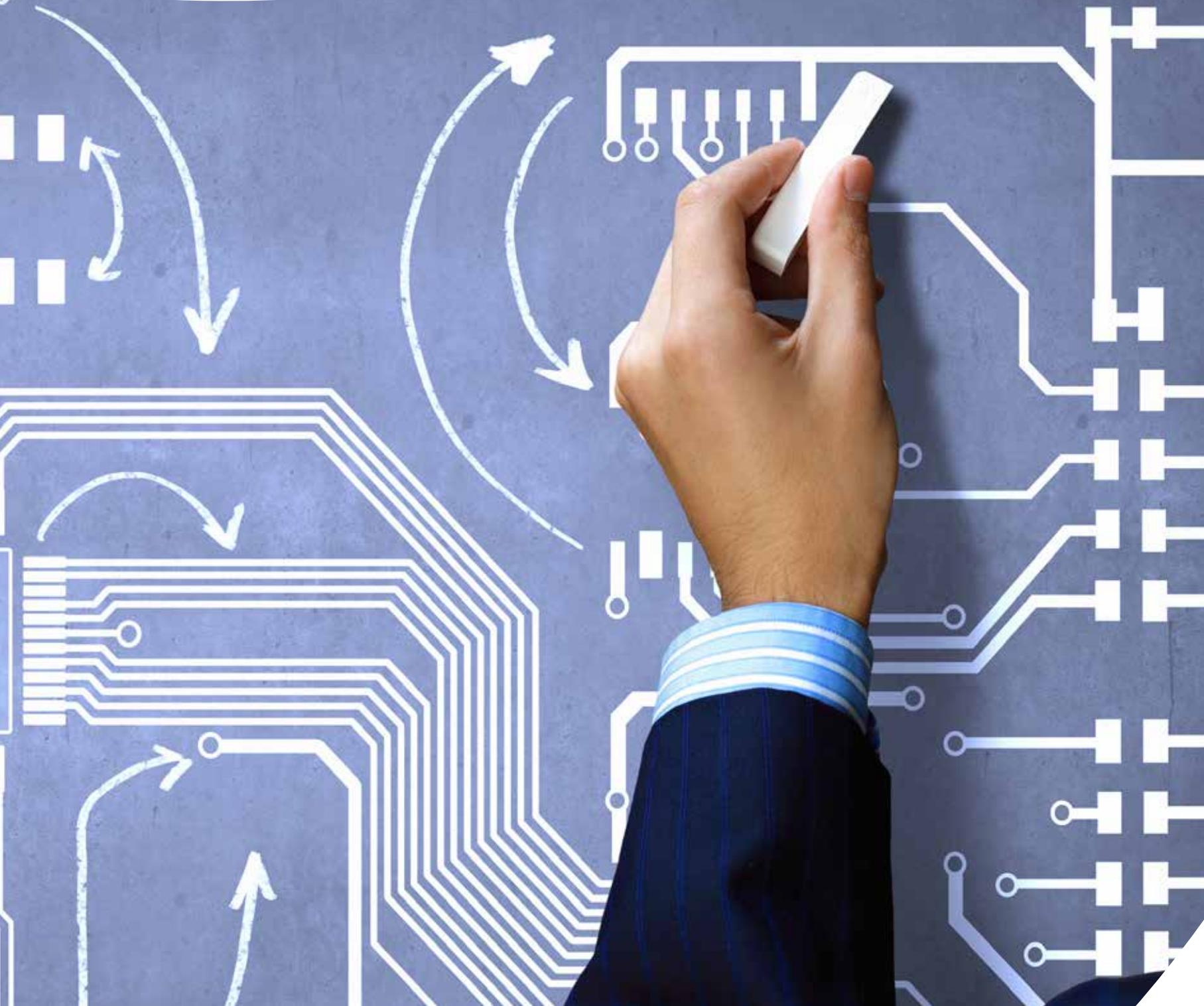
et

- compléter notre offre pour les forts volumes au travers de nos partenariats de longue date avec des fabricants asiatiques hautement qualifiés.

Valeurs

- Qualité
- Réputation, fiabilité et continuité
- Technologie de pointe
- Compétence et professionnalisme
- Passion, engagement, concrétude

La Division PCB de Finmasi a une présence globale avec quatre usines en Europe - deux en Italie, une en France, et une en Allemagne - et plusieurs bureaux de vente dans toute l'Europe.



Les projets de nos clients, nos PCBs

Nous offrons notre savoir-faire dans la conception et à la fabrication de circuits imprimés pour réaliser les projets de nos clients.

En tant que fournisseur de solution, la vocation de Cistelaier de Techci et EPN, fortes de leur savoir-faire historique, est de soutenir leurs partenaires le plus en amont possible des nouveaux projets au travers des activités de co-développement. Cela fait de la Division circuits imprimés du groupe Finmasi un partenaire idéal pour la fourniture de circuits imprimés de toutes typologies et pour tous types d'applications.

Toutes les données relatives aux produits sont systématiquement analysées afin d'identifier tous les facteurs de risque (analyse de risque) avec l'utilisation de DFM et d'AMDEC.

Cette méthode de travail supporte parfaitement notre offre de service de prototype et garantit la qualité et le taux de service dans tous les secteurs d'activités où nous sommes présents.

La Division circuits imprimés met l'accent sur l'analyse des besoins technologiques du marché et les activités de recherche et développement.

Cette approche permet d'anticiper les besoins de nos clients et d'être prêt à offrir aujourd'hui les solutions technologiques de demain.





Nos certifications

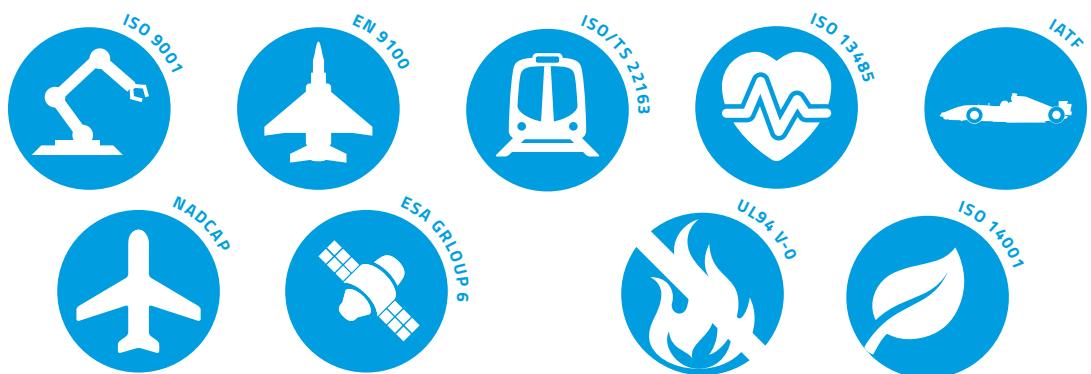
Le Système de Management Qualité des sites de production de la Division de circuits imprimés – Cistelaier, Techci et EPN a été organisé et déployé selon la norme ISO 9001 depuis plusieurs années. Nos produits peuvent être réalisés selon la certification UL94V-0 et son extension UL796 DS, délivrées par Underwriters Laboratories. La certification pour les circuits flex-rigides (norme d'inflammabilité V-0) a été obtenue en 2013.

Les homologations suivantes font de la division circuits imprimés un interlocuteur unique:

- Secteurs Aéronautique, Spatial et Militaire: UNI EN 9100:2016 et NADCAP
- Secteur Automobile: IATF:2016
- Secteur Médical: ISO 13485:2003
- Secteur ferroviaire: ISO/TS 22163.

Les produits sont fabriqués selon les normes suivantes et les plans de contrôle spécifiques validés avec nos clients lorsque nécessaire:

- IPC-A-600, classe 2, 3 ou classe 3DS(A)
- IPC 6012 (Rigide), IPC 6013 (Rigide-Flex), IPC 6016 (HDI) et IPC 6018 (Micro-onde)
- MIL-P-55110 (Rigide) et MIL-P-50884 (Rigide-Flex)
- ESA-ECSS - Q - ST - 70 - 10C / 11C / 12C
- ESA-ECSS - Q - ST - 70 - 60C
- les spécifications clients additionnelles.



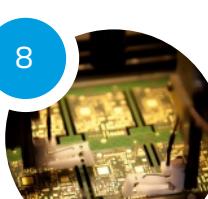
Nos équipes sont certifiées IPC avec:

- 4 personnes certifiées formateurs IPC
- 9 personnes qualifiées Spécialistes IPC



Nos atouts technologiques

- Investissements continus en machines et équipements de dernière technologie adaptés à la gestion des prototypes.
- Personnel hautement qualifié dans la fabrication de circuits imprimés et les méthodes de production et la gestion de la qualité.
- Production gérée selon les principes du Lean management. Tout cela permet à Cistelaier, Techci et EPN de répondre aux besoins de leurs partenaires en termes de Technologie, de Qualité et de Service.

- 1  Production des couches internes avec machines LDI, lignes DES et plusieurs machines de contrôle AOI.
- 2  Atelier de stratification avec 5 presses et un atelier spécifique pour le pressage des flex-rigides installés dans une salle blanche (classe 10K), une base à vide et une machine ITC pour le bouchage des via.
- 3  Atelier de stratification avec 5 presses et un atelier spécifique pour le pressage des flex-rigides installés dans une salle blanche (classe 10K), une base à vide et une machine ITC pour le bouchage des via.
- 4  Préparation des trous avant métallisation avec plasma pour les matériaux exotiques et métallisation cuivre chimique et processus palladium.
- 5  Exposition des faces externes avec de multiples machines LDI et machines d'exposition traditionnelles, contrôlées dans l'atelier AOI.
- 6  Exposition des faces externes avec de multiples machines LDI et machines d'exposition traditionnelles, contrôlées dans l'atelier AOI.
- 7  Les finitions Enig, Enepig, Immersion Tin, HAL, sont réalisées en interne avec un traitement spécial permettant d'améliorer la propreté de l'or.
- 8  Nombreux équipements de test électrique permettant de tester des cartes de 900 mm avec système de chargement et déchargement automatique. Tous les opérateurs sont formés au contrôle des cartes selon l'IPC ou les spécifications client.
- 9  Laboratoire de contrôle des procédés et de certification des circuits avec rapport de coupe métallographique. Contrôle dimensionnel automatique et contrôle des impédances.



Notre offre de service et produit

Notre objectif est de fournir "**un service global**" où "global" signifie que nous sommes capables et nous voulons fournir à nos partenaires:

Tous les services

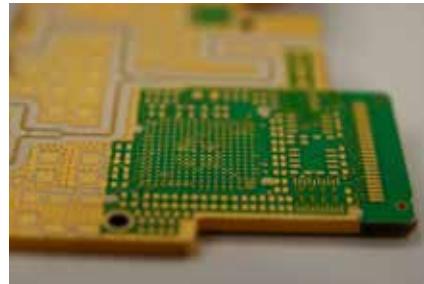
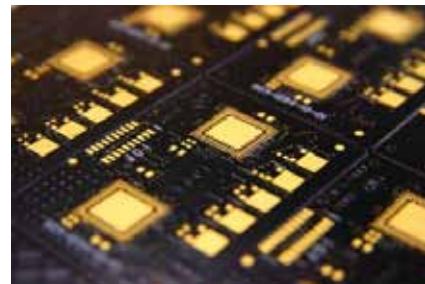
- Contrôle de règle de conception
- Conception pour la fabrication
- Appui de Co-conception
- Service rapide de prototypage

Toutes les technologies

- Rigide, Flex-rigides, HDI, Microwave et produits "spéciaux"
- longueur/largeur jusqu'à 855/464 mm
- Épaisseur jusqu'à 5 mm
- Épaisseur de cuivre jusqu'à 0,5 mm
- Insert de cuivre et réalisation de barre bus
- Plus de 100 différents types de matières premières
- ENIG, ENEPIG, étain chimique, HAL plombée et HAL sans plomb, argent, OSP, Nickel Or électrolytique (Hard and Soft), Etain plomb refondu (à l'huile)
- Vernis épargne vert, rouge, bleu, noir, blanc, gris et RAL spécifique sur demande

Tous les marchés/applications

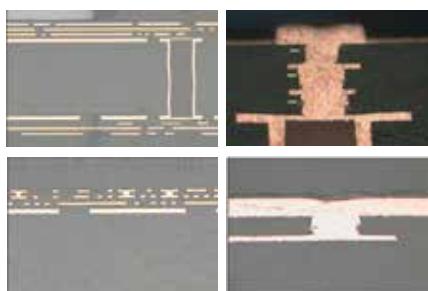
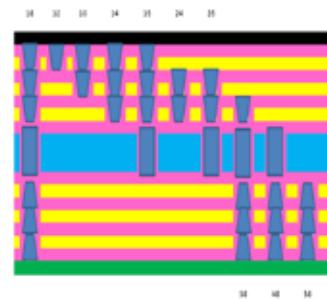
Nous sommes certifiés pour les domaines aéronautique & militaire, aviation civile, le ferroviaire, le médical et l'automobile et nous sommes également acteur pour les applications satellites dans le domaine spatial.

**Application:****Video Wall-Infotainment**

Technology: Multilayer SBU with 3+N+3 with Cu filled stacked vias burried filled & Capped vias

Material: FR4 High TG with filler Iteq IT180A

Finishing: Black solder mask and Enepig

**Application:****Military radar**

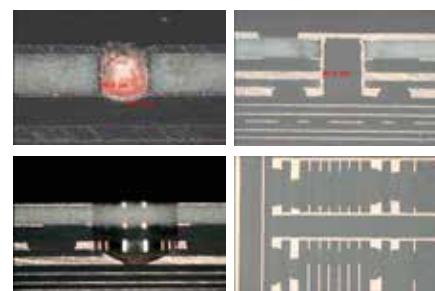
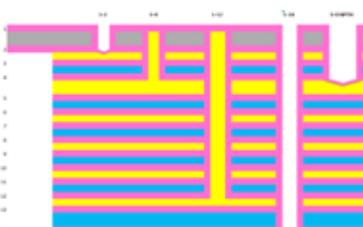
Technology:

Multilayer 14 layer mixed layup

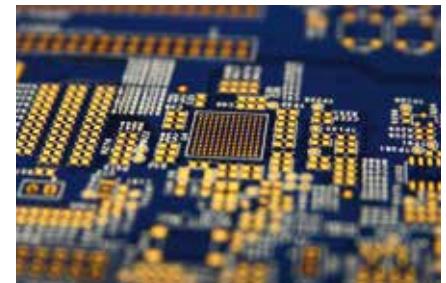
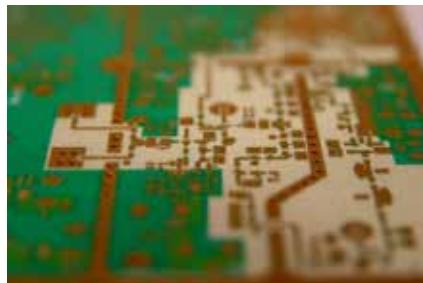
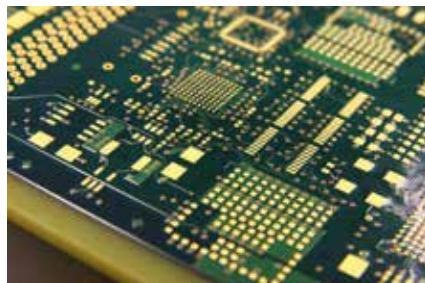
Material: FR4 High TG Iteq IT180 + Rogers RO3035 (Taconic RF35A2)

Via sequence: L1-L2, L1-L4 L1-L12 L1-L14 and cavity L2-L14

Finishing: Enig + Bondable 3 um plated gold



Rigid / Rigid - HDI RF - Microwave



Application:
Renewable Energy

Technology: Multilayer 10 layer SBU with 3+N+3 with Laser vias

Material: Low DK & DF material Isola Fr408HR High

Finishing: Enig

Application:
Telecom

Technology: Multilayer 8 layer mixed layup Via Filled and capped, back drilled hole

Material: FR4 High TG with filler + Rogers RO4350. Via Filled and capped, back drilled hole

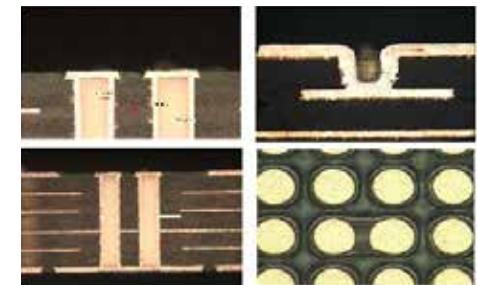
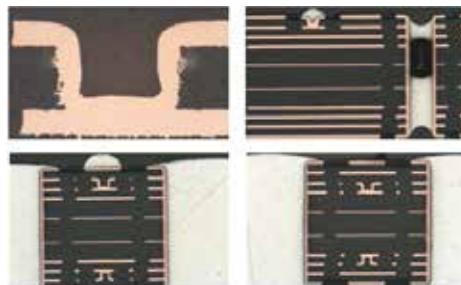
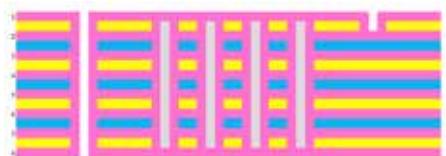
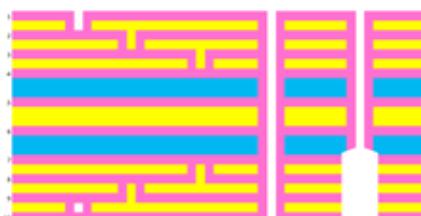
Finishing: Enig

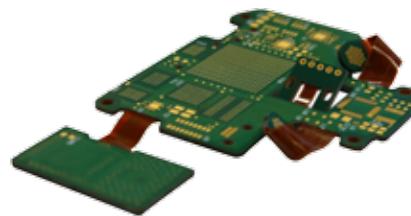
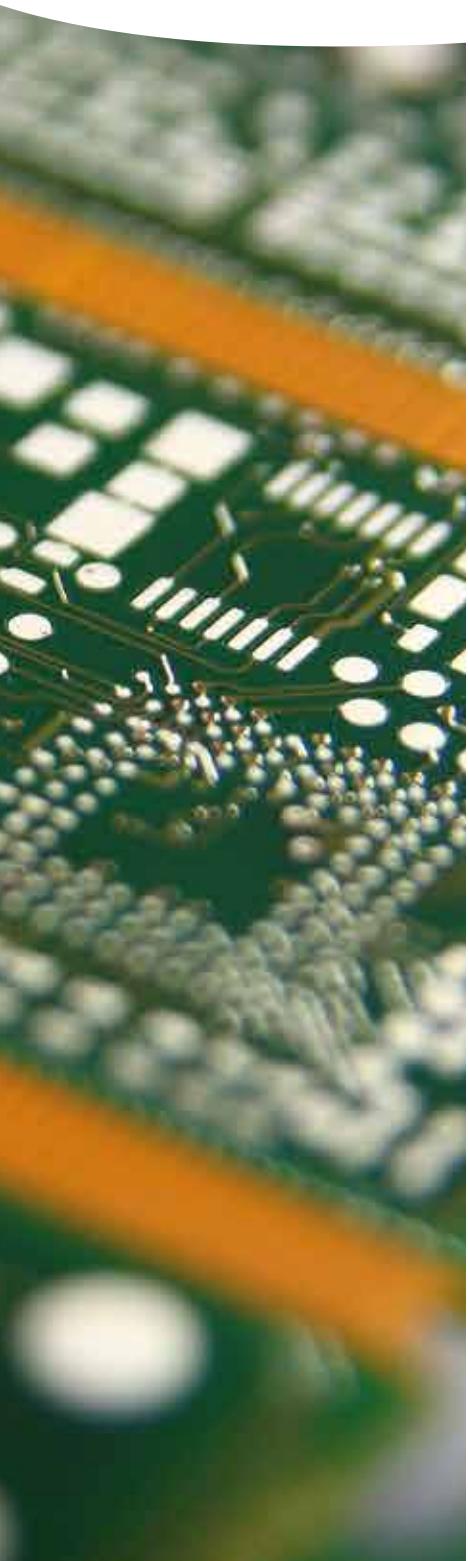
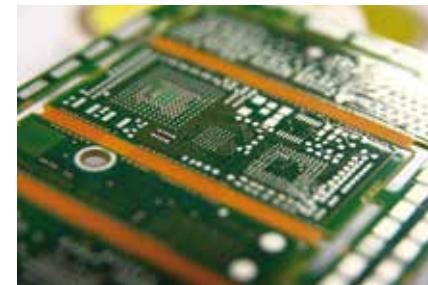
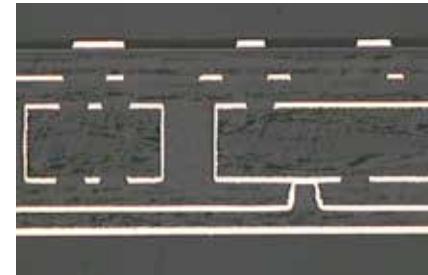
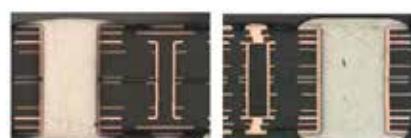
Application:
Medical

Technology: Multilayer 6 layer with laser via and UGBA pitch 0.4 mm via in pad resin filled

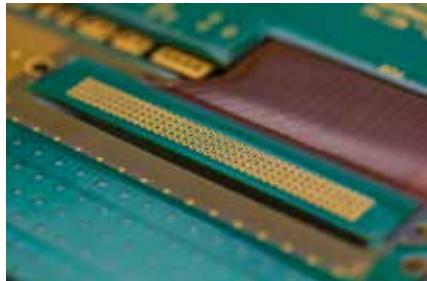
Material: FR4 High TG with filler Nelco N4000-29

Finishing: Blue solder mask and Enig



**Application:****Military – Wearable Device****Technology:** Multilayer 12L HDI
2+8+2 with laser via**Material:** Polyimide Ventec Vt901+
Adhesive Less Polyimide film**Finishing:** Enig and strain relief
(Eccobond) application on the
transition area**Application:****Industrial Automation****Technology:** Multilayer 6 Layer HDI
2+2+2 with laser via**Build up:** asymmetrical Kapton®
position**Material:** FR4 High TG Iteq IT180 +
Adhesive Less Polyimide film**Finishing:** immersion tin and partial
coverlay on outer layer

Flex / Rigid-flex Rigid Flex HD

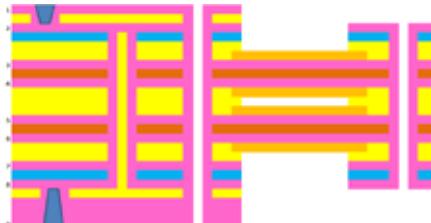

Application:
Military Sea & Groud Radar

Technology: Multilayer 9 layer with buried, blind Vias and impedance control, lenght 855 mm

Build up: buried terminals inside, two flex layer and bus bar with 500 µm of copper on top layer

Material: FR4 High TG, copper foil 500 µm and Adhesive Less Polyimide film

Finishing: Enig on outer layer and internal layer

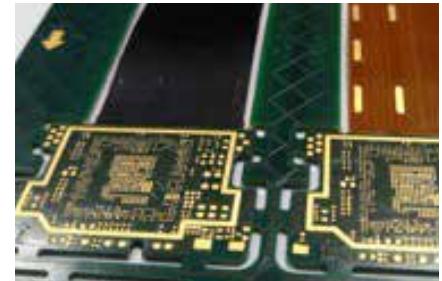
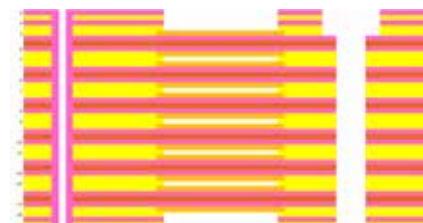

Application:
Military - Pointing System

Technology: Multilayer 16layer with 6 flex layer for dynamic application

Build up: cavity from top side to layer 3 on flex for opening on wire bondable pads

Material: FR4 High TG Iteq IT180 + Adhesive Less Polyimide film

Finishing: electrolytic Soft Gold inside cavity on flex + Enig and electrolytic hard gold on surface

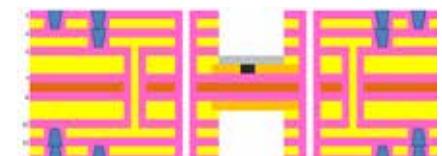

Application:
Infotainment – Sportive watch

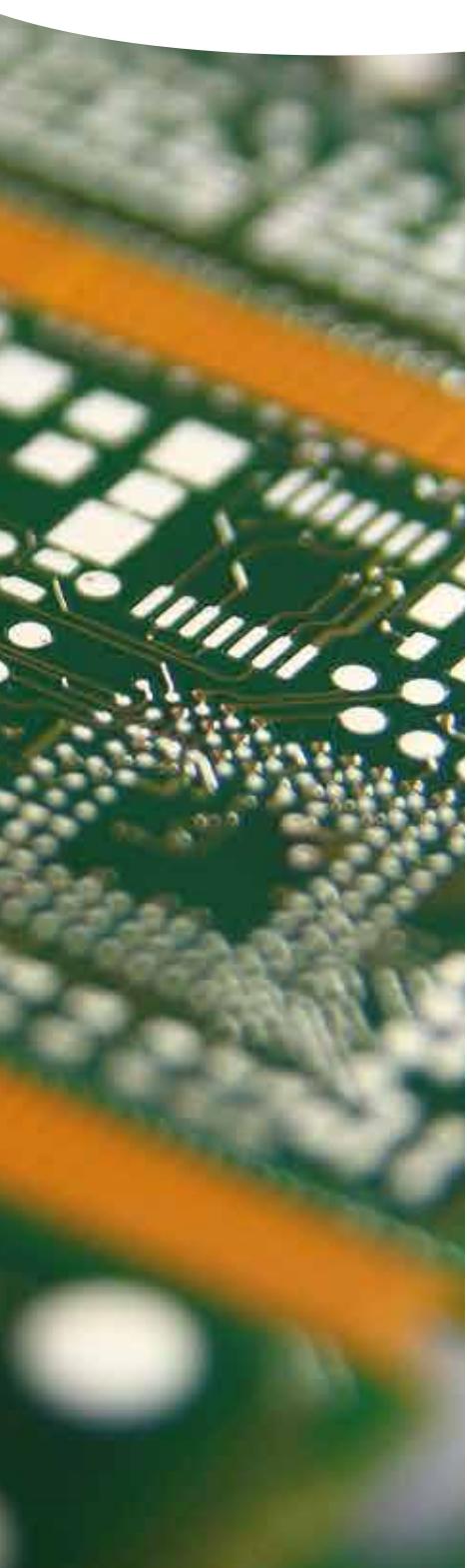
Technology: Multilayer 10 layer HDI with buried and stacked blind vias

Build up: very thin layup with Emi Shielding on flex layer

Material: FR4 High TG Iteq IT180 + Adhesive Less Polyimide film

Finishing: Enig and matt solder mask



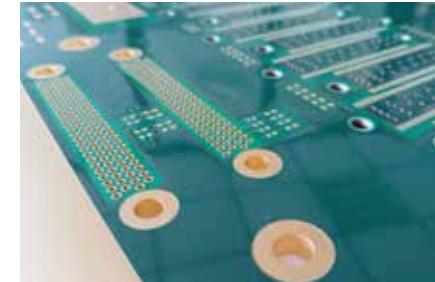
**Application:** Led Lightning and power Management

Technology: IMS printed circuit board long up to 1.5 mt in SS, DS and Multilayer

Material: low, medium and high thermal dissipation capacity on aluminum or copper

Mechanical: Routed, V-scored and punched

Finishing: Enig, Enepig, Hasl and OSP

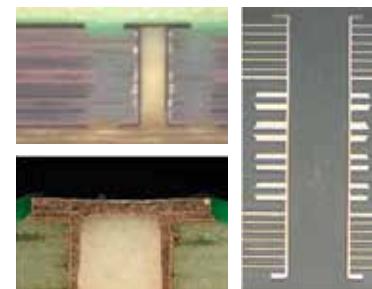
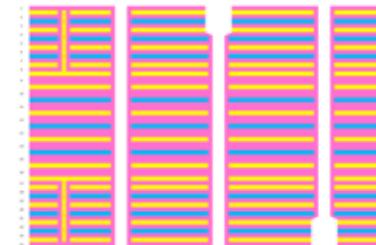
**Application:** Military Avionic Radar

Technology: Multilayer 24 layer blind vias filled and capped, lenght 640 mm with 4.20 mm thickness

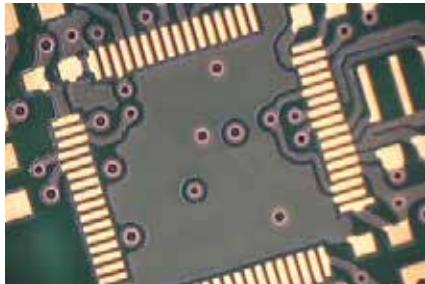
Build up: mixed build up, 17 µm and 105 µm for power management

Material: FR4 High TG with filler Iteq IT180A

Finishing: Green solder mask and Enig

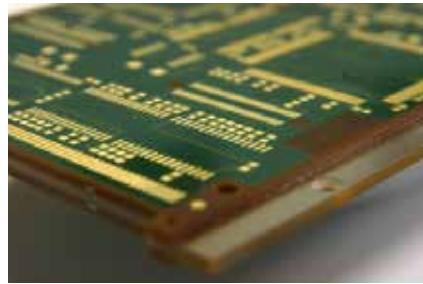


Special / IMS / Led

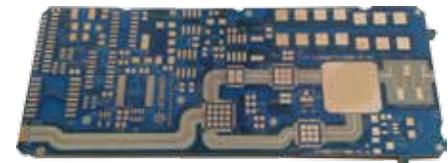

Application:
Automotive hybrid car
Technology: Multilayer MI8–Logic and power on same PCB with fine pitch

Layup: Mixed copper thickness 210 µm, 35 µm in the innerlayer and 105 µm on outer layer

Material: Fr4 High Tg with filler Iteq IT180A

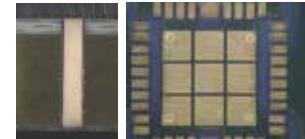
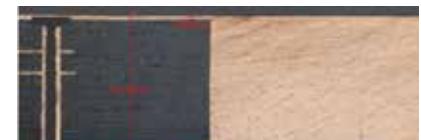
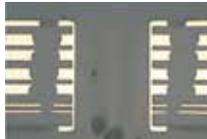
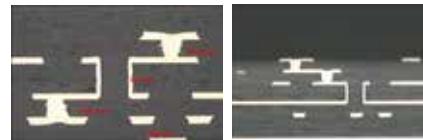
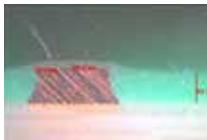
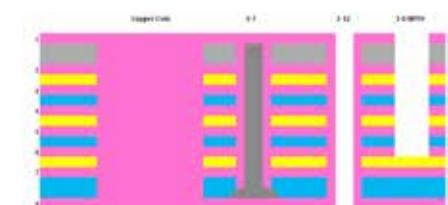
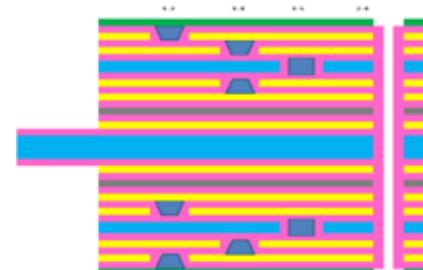
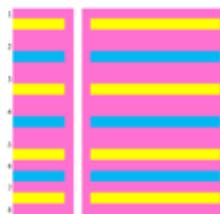
Finishing: Enig

Application:
Military Sea & Ground Radar
Technology: Multilayer SBU with 5+N+5 with Cu filled vias

Material: Polyamide + CopperInvarCopper

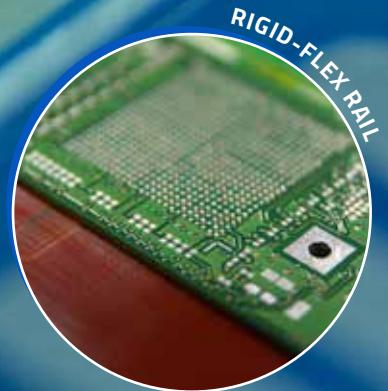
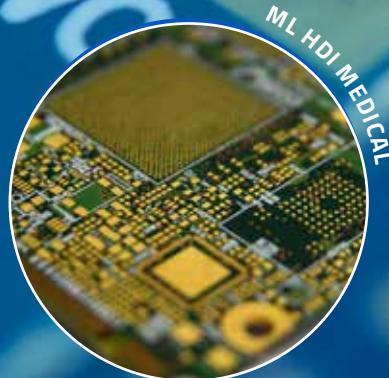
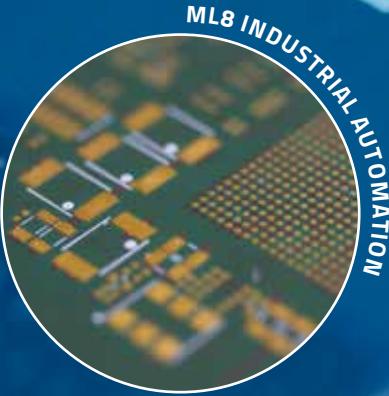
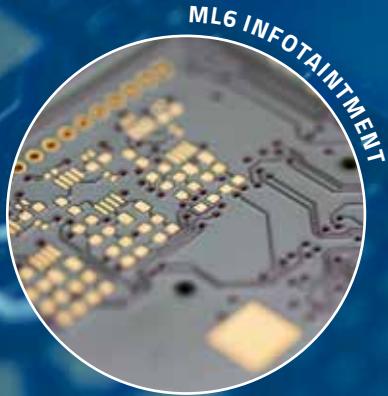
Finishing: Enig + cavity with Electrolytic Nickel

Application:
Military Sea & Ground Radar
Technology: Multilayer 8 layer with embeded copper coin

Build up: backdrilled vias filled and capped

Material: Fr 4 High Tg Iteq IT180 and Rogers Ro4350

Finishing: Enig + Electrolytic soft gold


La Division PCB offre à ses clients
“un point d'entrée unique pour l'acquisition
de l'ensemble de leurs besoins”
en matière de service et de PCB pour une
gamme allant des produits standards aux
produits de haute technologie et ce pour tout
type de volumes en garantissant le plus de
haut niveau de qualité.



Our technical abilities

Base materials for PCBs

Standard FR4, high Tg Laminates also Halogen Free and specific for High Speed Digital:

- FR4 standard & Leadfree: Iteq IT140 & IT588; Isola Duraver ML104i - Tg 140 °C; Black FR4
- Mid Tg epoxy for Lead-free process: Iteq IT158 -Tg 160 °C; Isola IS400 -Tg 150 °C
- Mid Tg- Halogen Free: Iteq IT40G -Tg 140 °C, IT150G;
- High Tg 180°C epoxy (without filler): Iteq IT180 (also No/Low flow Prepreg); Isola IS420& IS410; ARLON 45N
- High Tg 180°C epoxy (with filler): Iteq IT180A & IT180i; Isola PCL370HR; Nelco N4000-29; Hitachi 700GR; EMC 827 i
- High Tg 170°C epoxy – Halogen Free: Iteq IT170GRA1 & IT170G & IT180GN
- High speed application: Nelco N4000-13(Si) & N4800-20(Si); Isola Fr408HR, IS600(series), Astra and I-Tera; Iteq IT200DK and IT150DA(SE), IT-968 (SE), IT-988G, IT-988G SE; Panasonic Megtron6 and Megtron7
- Capacitance layer: OAK-Mitsui Faradflex

High-performances materials for avionic/military application:

- Polyimide Resin System: Arlon 33N, 35N, 84N, 85N, 85HP; Ventec VT901(also No/Low flow); Hitachi MCL-I-671; Isola 95P/96P; NELTEC N 7000VO
- Epoxy Resin System: Arlon® Kevlar 4NK (Tg 170 °C and 4.7 ppm/°C)
- Epoxy and Polyimide Thermount® & Para Aramid fiber: ARLON® 55NT/85NT
- Copper/Invar/Copper: tipically 150 µm thick - 17/120/17 µm)
- Thick copper: up to 500 microns and over, for BusBar application and copper inlay&coin technology

Substrates for flexible circuits:

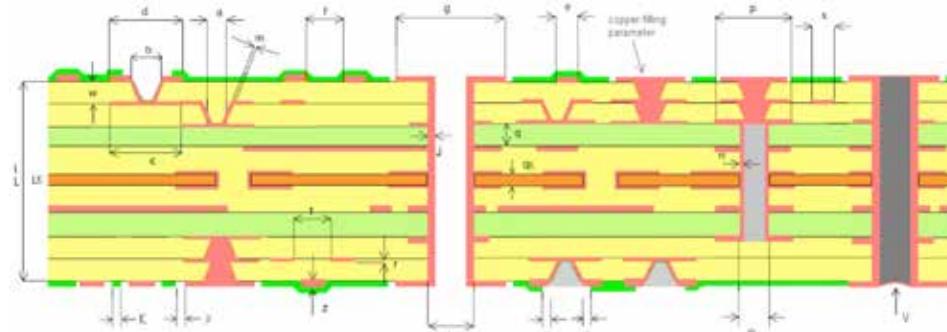
- Flexible Laminates-Polyimide film based: DuPont PYRALUX LF; PYRALUX FR;
- Flexible Laminates- Polyimide film based Adhesiveless: PYRALUX AP, PYRALUX AP-Plus & PYRALUX TK
- Flexible Laminates-Polyimide based Adhesiveless: UBE Upilex 25-50-75 µm; Iteq 25-50-75 µm
- Emi shielding layer: Tatsuta SF-PC6000 and TATSUTA SF-PC 3300

High Frequency materials Teflon® based and non-Teflon based:

- Rogers® / Arlon(also Copper/Brass supported): RT/Duroid Family; RO3000 Family; TMM Family; Di-Clad Family; Isoclad Family; Cuclad Family; AD Family; AR Family; TC Family
- Rogers® / Arlon®: RO4350 & RO4003 (Back up material for discontinued 25N & 25FR but partially applicable)
- Rogers®: ULTRALAM® 3850HT - Liquid Crystalline Polymer (LCP)
- Iteq "new generation" material for RF and Microvawe applications IT-88GMW, IT-8300GA, IT-8338G, IT-8338A, IT-8350G, IT-8350A, IT-8615G with Dk from 3,00 up to 6,15,(05)
- Taconic®: RF25A2, RF35, RF35A2, RF45, RF60, TSM-DS3, Cer10, FastRise, TACLAM Plus and all teflon family (TLX, TLY, TLE)Nelco: Mercurywave series, Meteorwave (1000 & 4000 Series) and all teflon family
- Foam: Rohacel HF51

Technical details

- Plated Through Hole:** minimum finished diameter 150 µm - Aspect Ratio for PTH: ≤ 12
- Blind Microvia:** minimum drilled diameter 60 µm (laser drilled) - Aspect Ratio for blind vias: ≤ 1
- µVias treatment:** Copper filled blind vias and Capped blind vias
- Vias treatment:** Capped through vias with TAIYO THP-100DX1, Prepreg EMC 8271 or Ventec VT901 or Arlon 85N
- Fine line:** minimum track/spacing is 50 µm, ±10 tolerance with 9 µm copper
- Layer count:** standard up to 32, special requirement over this value after DFM evaluation
- Flexible Layer count:** up to 6 inner layer in a Rigid-Flex build up, special requirement over this value after DFM evaluation
- Sequential lamination:** up to 3+N+3 (SBU), special requirement over this value after DFM evaluation
- Cu thickness on layer:** Thin copper 5 µm; 9 µm; 12 µm, from 17 µm, 35 µm, 70 µm, 105 µm and heaviest up to 500 µm, special requirement over this value or selective thickness on same layer after DFM evaluation
- Cu thickness on vias:** IPC class 2, class 3 and 3DS as standard, special requirement like plating up to 100 µm for power and heat management, also selectively, can be performed
- Minimum Inner layer thickness:** 50 µm, special requirement after DFM evaluation
- Minimum Prepreg thickness:** 50 µm (1 x PP106) or lower but after DFM evaluation (PP1027 or PP1037)
- Minimum Flexible layer thickness (Adhesive less):** 50-75-100-125-150 µm as standard, lower and higher thickness as special requirement
- Maximum PCB thickness:** 5.5 mm
- Maximum PCB dimensions:** Standard: 464 x 566 mm, up to 855 x 464 mm after DFM evaluation
- Solder Mask:** curtain coated (Green), spray coated or screen printed (special and colored)
- Solder Mask capability:** Solder Dam 100 µm standard and 70 µm special; Clearance down to 40 µm
- Vias Treatment:** All process like per IPC4761 classification
- Printing application:** legend, Peelable mask, graphite and resistive inks and serialization (numbering, 2D barcode, QR Code, Datamatrix, standard barcode)
- Finishing:** Hasl with/without Lead; Enig (Al bondable); Immersion Tin & Silver; ENIPIG (Au bondable); Galvanic hard and soft gold, tin-lead hot oil reflow
- Heat dissipator:** Aluminum & Copper Heat Sink, printed heat sink with Peters HSP2741 resin
- Heat dissipation & Power management techniques:** copper inlay and copper coin techniques (Pressfit, Embedded and post bonded)



Symbol	Parameter	Value	Symbol	Parameter	Value
A/B	Min. Vias laser	50 µm	J/N	Min. Cu Th.ss in Burried and Through vias	>20 µm
C/D	Min. Anular ring on laser via	>+100 µm	Q	Min. thickness rigid base material	50 µm
E/F	Min. line/space on base Cu9µm–Outer layer	68 µm	Qk	Min. thickness flexible base material	25 µm
G/P	Min. Anular Ring on Burried hole and PTH	>+150 µm	S/T	Min. line/space on base Cu17µm–Inner layer	68 µm
H/O min	Min. Mech. Plated Through Hole à l value	0.1 mm	R	Min. Copper Th.ss Inner layer	12 µm
H max	Max. Plated Through Hole	unlimited	Z	Min. Copper Th.ss Outer layer	9 µm
O max	Max. Plated Burried hole	1.2 mm	V	Dimple in resin filled plated Through hole	<18 µm
I min	Min. core thickness on DS - flex	25 µm	W	Min. prepreg core thickness	50 µm
I max	Max. pcb thickness on ML	5.20 mm	Y	Min. Solder mask Opening on vias	100 µm
L	Max. No. of Layers	40 layers	K	Minimum Solder mask dam	75 µm
LK	Max. No. of Flex Layers	12 layers	X	Min. solder mask clearance	50 µm
M	Min. Cu th.ss in laser/blind vias	> 12 µm	Cu Filling	Preferred Design parameter for Cu filling	W=75µm /B=90µm

Technical capabilities chart										Classification									
Item	Description (all relative measures are expressed in mm)	Standard				Advanced			R&D										
		5	6	7	8	9	10	10											
Track & Gap	min Track to Track (TT)/Track to Pad (TP)/Pad to Pad (PP)/Thermal Line Width (TW)	150	125	100	87	87	75	75	60	50									
	min Track Width (MTW) / min Thermal Gap (GAP)				87	75	87	75	60	50									
Ring Rigid pcb	min Outer Layer Annular Ring (OAR) on Production Hole Diameter (PHD)	150	125	100	100	100	100	100	87	75									
	min Inner Layer Annular Ring (IAR) / Thermal Annular Ring on PHD	175	150	150	125	125	100	87	75	75									
Hole Diameter	min Production Hole Diameter (PHD) for thickness 1.6 mm (Others: see table)	400	350	300	250	250	200	150	125	100									
	max aspect ratio PTH: see also table (Thickness / PHD)	4	5	6	8	10	11	12	14	16									
μvia – Burried via	min blind μvia drill diameter - material with glass					150	125	100	75	50									
	max blind μvia aspect ratio - material with glass (Thickness / PHD)					0.5	0.6	0.7	0.8	1.0									
	min blind μvia drill diameter - material without glass					125	100	87	75	67									
	max blind μvia aspect ratio - material without glass (Thickness / PHD)					0.55	0.65	0.75	0.85	1.0									
	μvia top pad annular ring					100	75	60	50	50									
	μvia landing pad annular ring					100	75	60	50	50									
	μvia holewall distance to cu					200	175	150	150	140									
	max number of laser runs/side					1	1	1	2	3	4	4	4	4					
	max number of burried vias					1	1	2	4	6	8	10	10	10					
Drill /Cu Distance	PTH to cu on inner layers (means IAR + Value)	+75	+75	+75	+75	+75	+75	+75	+68	+60	+50								
	NPTH to cu on inner layers /NPTH Routing always>250 µm (means IAR+Value)	+50	+50	+50	+50	+50	+50	+50	+50	+50	+50								
	NPTH to cu on outer layers (NPTH Routing always >200 µm)	250	200	200	200	200	150	125	100	75									
Cu Thickness	maximum total cu thickness that can be etched (no minimum)	70	50	40	25	20	20	15	15	12									
Solder Mask	solder mask annular ring (MAR) & conductor overlap (MOC): typical	80	75	75	75	60	60	50	40	30									
	solder mask annular ring (MAR) & conductor overlap (MOC): exceptional					60	60	50	40	30	25	25	25	25					
	solder mask min segment (MSM) (If Cistelaier creates SM, MSM >= 100)	125	110	100	100	90	90	80	70	60									
Build up	max pcb thickness (mm)							>3.2	>3.2	5.00	5.20								
	min pcb thickness tollerance (%)	10	10	10	10	10	8	7.5	5	5	5								
	max nr. Layers (for the Flex layer add 1unit in complexity)	12	16	18	20	22	24	26	32	40									
Ring ML Flex & Flex-Rigid Flex layers (for rest = 0) should be 100 µm bigger then on rigid boards;																			



Cistelaier S.p.A. con Socio Unico
Via Gandhi, 1
41122 - Modena - Italy

Tel.: +39 (0) 59 269711
Fax.: +39 (0) 59 250165

info@cistelaier.com
www.cistelaier.com



Techci Rhône-Alpes SA
Za du Truison
73240 - Saint-Genix-sur-Guiers - France

Tel.: +33 (0) 476 31 50 06
Fax.: +33 (0) 476 31 71 55

info@techci.fr
www.techci.fr



EPN Electroprint GmbH
In den Gruppenäckern 2
07806 - Neustadt an der Orla - Germany

Tel.: +49 (0) 3 64 81 59 50
Fax.: + 49 (0) 3 64 81 59 555

info@epn.de
www.epn.de